



美格智能 SRM819W模组

5G Advanced Ready LGA封装模组

SRM819W是基于高通®X85调制解调器及射频的新一代5G-A通信模组。符合最新的3GPP Release 18标准,支持5G毫米波及Sub-6 GHz网络,增加了R18新标准引入的多个新频段和组合,可满足全球5G网络的接入。模组支持6CC的5G下行多载波聚合和1024QAM调制解调,最大带宽可达400MHz,下行速率可突破12.5Gbps。此外,模组可支持UL 2CC、SUL等超级上行技术,最高上行速率可达3.7Gbps。SRM819W模组同时配备8RX天线接收和29dBm的PC1.5发射功率,还可支持NB-IoT NTN卫星通信,确保在各类环境下提供稳定、广覆盖的高质量连接体验。

模组采用LGA封装,尺寸为56x53x2.95mm,可支持OpenWRT、RDK-B和prpIOS多种操作系统,配备可扩展的eMMC+DDR存储设计,拥有超强的处理能力。模组同时集成了丰富的高速接口,包括三组PCIe、两组USXGMII和USB3.1等,可满足各类终端设备的高速接入需求,显著提升5G终端的开发效率并降低开发成本。

在Wi-Fi配套支持上,SRM819W支持灵活的Wi-Fi 7配置方案,如双频4x4 BE7200,双频2x2 BE3600等配置方案,并支持EasyMesh™技术及更安全可靠WPA3 R3加密协议,为用户提供安全、稳定的无线网络接入。

主要优势:

- 符合3GPP Release 18标准,满足全球5G网络的接入
- 支持5G毫米波及Sub-6GHz网络
- 支持多种边缘AI处理能力
- 最大带宽可达400MHz,下行速率可突破12.5Gbps
- 支持UL2CC、SUL等超级上行技术,最高上行速率可达3.7Gbps



5G Advanced



支持AI协作处理器



LGA封装



多组PCIe/USXGMII



支持多种系统



-10°C-55°C

MeiG Smart SRM819模组

5G Advanced Ready LGA封装模组

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性:

- 封装: LGA 封装
- 尺寸: 56.0×53.0×2.95mm
- 重量: <20g

模组速率:

- 5G NR:
 - 11Gbps DL/3.7Gbps UL
- LTE:
 - 2Gbps DL/200Mbps UL
- WCDMA:
 - 42.4Mbps DL/5.76Mbps UL

驱动&工具:

- 驱动: Android 4.2/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0, Windows 7/8/10/11, Linux 2.6 or later
- USB升级, FOTA升级

网络协议:

- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX

发射功率:

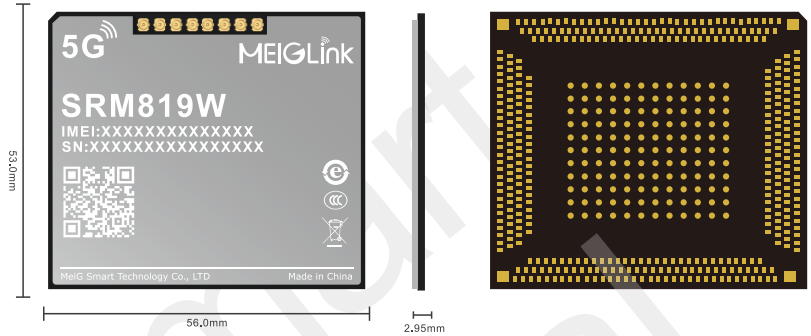
- XXXXXXXXXXXXXXXXXX

模组接口:

- USB3.1 × 1
- PCIe Gen3.0 × 3
- USXGMII × 2
- USIM × 2
- 天线接口:
 - mmWave RF Connector x8
 - ANT_PRI/ANT_DIV/ANT_MIMO x6
 - 8RX x4
 - GNSS x1

认证信息:

- CE*/FCC*



环境温度湿度特性:

- 正常工作温度: -10°C to +55°C

SRM819W系列频段信息:

-EA:
5G NR mmWave:
N257/258/259
5G Sub6G:
FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N71/N75/N76
TDD:N38/N40/N41/N77/N78
LTE:
FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71
TDD:B38/B40/B41/B42/B43

-NA:
5G NR mmWave:
N259/260/261
5G Sub6G:
FDD:N2/N5/N7(30)/N12/N13/N14/N25/N26/N29/N66/N71
TDD:N38/N41/N48/N77/N78
LTE:
FDD:B2/B4/B5/B7(30)/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71
TDD:B38/B41/B42/B43/B48

备注: * 研发中

